

明新科技大學114學年度教師產業研習

半導體封裝測試與設備實務應用培訓營-第二梯次課程簡章

主辦單位	明新科技大學				
課程時間 / 課程名稱/師資	第二梯次(10 天，共 70 小時)				
	日期	時間	培訓內容	講員	服務機構
	7/13 (一)	8:30 – 12:00	QFN 封裝設備人機介面參數設定	陳慶恩	廣化科技公司 資深研發工程師
		13:00 – 16:30	QFN 封裝設備操作能力評量	陳慶源	廣化科技股份有限公司 資深工程師
	7/14 (二)	8:30 – 12:00	先進封裝的技術挑戰	張香鉞	工研院電子與光電系統所 異質整合智能系統組經理
		13:00 – 16:30	晶圓切割機操作能力檢測	何信松	力成科技公司資深工程師
	7/15 (三)	8:30 – 12:00	溫室低碳減排	洪君伯	明新科技大學 工業工程與管理系副教授
		13:00 – 16:30	黏晶機操作能力評量	林賢昇	力成科技公司資深工程師
	7/16 (四)	8:30 – 12:00	IC 封裝產業環境汙染處理	江鎔帆	力成股份有限公司 工安二部副部經理
		13:00 – 16:30	打線機操作能力評量	黃志賢	力成科技公司資深工程師
	7/17 (五)	8:30 – 12:00	封裝產業廠務系統介紹	盧麒泰	力成股份有限公司 廠務副部經理
		13:00 – 16:30	基礎半導體測試概論	陳啟文	明新科技大學 電子工程系教授兼 半導體學院院長
	7/20 (一)	8:30 – 12:00	測試系統基礎架構介紹	沈添賜	明新科技大學 電子工程系助理教授
		13:00 – 16:30	元件直流參數量測	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理
	7/21 (二)	8:30 – 12:00	自動化測試機台簡介及內部測試模組架構	周志忠	美達科技股份有限公司 技術支援部資深工程師
		13:00 – 16:30	自動化測試機台內部測試模組使用指令介紹	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理
	7/22 (三)	8:30 – 12:00	IC 元件特性與量測介紹	周志忠	美達科技股份有限公司 技術支援部資深工程師
		13:00 – 16:30	測試程式開發--整合型多工 IC 測試機	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理

	7/23 (四)	8:30 – 12:00	測試程式開發--電源管理元件測試機	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理
		13:00 – 16:30	測試程式開發能力評量--電源管理元件測試機	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理
	7/24 (五)	8:30 – 12:00	自動晶圓探針台介紹及實務程序操作	沈添賜	明新科技大學 電子工程系助理教授
		13:00 – 16:30	自動晶圓探針台介紹及實務操作評量	劉文正	美達科技股份有限公司 技術支援部副理
開課日期	第二梯次： 115 年 7 月 13 日(一)至 115 年 7 月 24 日(五)，共 10 天，上午 8 時 30 分至下午 4 時 30 分				
開課地點	明新科技大學半導體技術中心、電子工程系館-210 教室				
合作機構	明志科技大學教師產業研習研究專案辦公室 工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組 力成科技股份有限公司 廣化科技股份有限公司 美達科技股份有限公司				
參與對象	高中職及大專院校教師				
收費標準	免費				
招生人數	招生人數 30 人				
報名網址	https://forms.gle/jQtvy4DZymReEbBh9				
	  活動報名 QR Code 活動公告 QR Code				